



生产型号	S板	工厂	交货日期
8V005GXTA0	P3		2016/7/2

工艺名称	编写	审核	状态	难	PPC	文控
铝片钻孔	张明丹	张明丹	已上网			李兰
钻孔	张明丹	张明丹	已上网			李兰
去毛刺	张明丹	张明丹	已上网			李兰
沉铜前烘板	张明丹	张明丹	已上网			李兰
沉铜	张明丹	张明丹	已上网			李兰
负片电镀	张明丹	张明丹	已上网			李兰
负电镀磨板	张明丹	张明丹	已上网			李兰
负片干膜	张明丹	张明丹	已上网			李兰
干膜检查	张明丹	张明丹	已上网			李兰
负片蚀刻	张明丹	张明丹	已上网			李兰
外层AOI	张明丹	张明丹	已上网			李兰
阻焊塞孔	张明丹	张明丹	已上网			李兰
阻焊	张明丹	张明丹	已上网			李兰
阻焊检查	张明丹					
字符	张明丹					
无铅喷锡	张明丹					
阻抗测试	张明丹					
电子测试	张明丹					
二钻	张明丹					
铁板	曹林文					
功能检查	张明丹					
终检	张明丹					
包装	张明丹					
成品仓	张明丹					

生产型号	8V005GXTA0	E工号	843632
板厚	1.60	板材	IT-180A
成长	176.5	成宽	123.06
字符	白色字符	阻焊	绿色
		验收标准	IPC-6012 III级
		PNL规格	1P=4U
		终端客户代码	

合并工号	生产型号	周期

沉铜前烘板: 工序基本参数

NO	项目	参数
1	烘板温度(℃)	按规范
2	烘板时间(小时)	按规范

无铅喷锡孔壁分离 - Microsoft Word

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 工具(T) 表格(A) 窗口(W) 帮助(H) Adobe PDF(B) Acrobat 注释(C)

100% 单阅读(R) 正文 + 宋体 宋体 五号 B I U A A

针对无铅喷锡订单, 制作要求如下:

- ①对于有金属化圆孔(直径 $\geq 3\text{mm}$)或金属化槽孔(长边 $\geq 5\text{mm}$)的设计, 且表面工艺为无铅要求 ERP 编写中沉铜前添加流程: 沉铜前烘板(参数 $150^{\circ}\text{C} \times 2\text{h}$);
- ②对于板厚 $\geq 2.5\text{mm}$, 层数 ≥ 4 , 且表面工艺为无铅喷锡, 若含有金属化圆孔(直径 $\geq 3\text{mm}$); (长边 $\geq 5\text{mm}$), 该类型孔优化设计为:
 - a. 客户已设计内层焊环的, 焊环需保留;
 - b. 客户若无设计内层焊环, 工程预审需建议此类圆孔或槽孔增加内层焊环; 若客户不同意, 接受此类型孔存在孔壁分离的风险。否则提出评审。
 - c. 圆孔和槽孔内层焊环设计按照《内层焊环制作规范》(对于局部因间距等无法加大的, 局做控制)。

以上所要求的圆孔及槽孔大小皆按ITD12

型号查询 X 指示审核 H 编写流程 E 保存信息 S

工具完成 叠层验算 取消修改 C 修改信息 B

在线WIP 调单导入 PPC审核 型号上网 W

能力参数 传送文件 ECN影响 发送指示 V

制作通知单 内部ECN ECN文控 回退审核 B

按从旧资料 流程对比 指示检查